



办公系统登录

师资队伍

[学院教师](#)[兼职教师](#)[杰出人才](#)

信息搜索

土木学院

学院通知

- 2019-2020学年土木工程学院本科生优良学风班拟推荐班级公示
- 2019-2020学年土木工程学院本科生校长奖学金拟推荐人选公示
- 关于第五届全国建设类院校施工技术应用技能大赛校内选拔赛获奖结果的公示
- 2020级土木-优秀研究生入学学业奖学金汇总表
- 2020年沈阳建筑大学优秀研究生入学学业奖学金 土木工程学院评审实施细则

当前位置: 首页 > 师资队伍 > 学院教师 > 教授 > 正文



师资队伍

李宇鹏(二级教授)

2019年03月22日 16:07 点击: [4675]



姓名: 李宇鹏

职务: 沈阳建筑大学副校长

职称: 二级教授、机电一体化教授研究员级高级工程师

研究方向:

- 1) 结构可靠性、
- 2) 复合材料结构性能分析

联系方式: Email: jyp@sjzu.edu.cn

通讯地址: 辽宁省沈阳市浑南区浑南中路25号沈阳建筑大学

邮编: 110168

教育背景:

- 1) 2001.07-2005.12 Washington University in St. Louis,美国,博士, 应用力学专业
- 2) 2004.07-2005.12 Washington University in St. Louis,美国,硕士, 结构工程专业
- 3) 1998.09-2001.07重庆大学(原重庆建筑大学),硕士, 结构力学专业
- 4) 1994.09-1998.07重庆大学(原来重庆建筑大学),本科,土木工程专业

工作履历:

- 1) 2018.08-至今沈阳建筑大学, 副校长、二级教授
- 2) 2014.02-2018.08辽宁能源投资集团, 副总经理
- 3) 2012.04-2014.02沈阳机床集团, 集团总工程师兼设计研究院院长
- 4) 2006.01-2012.07美国英特尔公司,项目经理和技术主管
- 5) 2001.07-2005.12美国华盛顿大学,助教助研兼讲师工作

获得荣誉称号:

- 1) 2019年, 沈阳市高层次人才杰出人才
- 2) 2018年, 国务院特殊津贴
- 3) 2003年, 获美国Chi Epsilon优秀学者荣誉奖

学术及社会兼职:

- 1) 2018年, 辽宁省第十二届政协委员
- 2) 2017年-至今, 辽宁省委省政府第六届决策咨询委员会委员
- 3) 2014年-至今, 辽宁省欧美同学会常务理事

主要学术论文:

- 1) **Yupeng Li**, Weiyang Meng, Huaitao Shi, Zhijun Gao, Ke Zhang, Guochang Li, Bing WANG, A Cost-effective Solution to Improving the Electrical Performance of metal Contacting Interfaces in IC System under Temperature-Humidity Environment [J]. Applied Sciences, 9(19): 3950, 2019.
- 2) **Yupeng Li**, Robert Atkinson, et al., "Numerical Prediction of Socket Solder Joint Reliability during Shock", 54th IEEE Holm Conference on Electrical Contacts, October 27-29, 2008, Orlando, Florida.

- 3) **Yupeng Li**, Srinivasan Sridharan, "Performance of Two Distinct Cohesive Layer Models for Tracking Composite Delamination" ,*International Journal of Fracture*, 136:99-131, 2005.
- 4) **Yupeng Li**, Srinivasan Sridharan, "Investigation of Delamination Caused by Impact Using a Cohesive-Layer Model" ,*AIAA Journal*,43(10): 2243-2251, 2005.
- 5) **Yupeng Li**, Srinivasan Sridharan, "Some Issues in Cohesive Layer Modeling of Composite Delamination" ,*Joint ASME/ASCE/SES Conference on Mechanics and Materials*, June 1-3, 2005, Baton Rouge, Louisiana.
- 6) **Yupeng Li**, Delamination of Composites Structures under Lateral Impact and Inplane Compression, Washington University, 2005.
- 7) **Yupeng Li**, Delun Wu, "A Discussion of the Large-Incremental Method of Calculation" ,*ACTAMechanicaSolidaSinica, Chinese Journal of SolidaSinica*, 22: S. Issue, 2001.
- 8) Weiyong Meng,**Yupeng Li**, Xiaochen Zhang, Huaitao Shi, Yu Zhang, Xiao Lv, The damage criterion affecting life prediction of Fiber Reinforced Al-Li alloy laminates under spectrum loading,*International Journal of Aeronautical & Space Sciences*, May, 2020
- 9) Bing Wang,**Yupeng Li**, Fei Liu, Analysis of passenger traffic in Bohai Strait Tunnel, International Conference CIBv2019 Civil Engineering and Building Services, Materials Science and Engineering, 789: 1-7, 2020.
- 10) **Weiyong Meng, Yupeng Li, Xiaochen Zhang, Yu Zhang, Yawen Wang, Xiao Huang**, Analysis and prediction on total fatigue life problems of fiber reinforced metal laminates under two-stage loading,*Composite Structures*,237: 111960, 2020.
- 11) **Huaitao Shi, Zimeng Liu, Xiaotian Bai, Yupeng Li**, A theoretical model to predict the effect of cracks in the local spalling of full-ceramic rolling bearings, *Applied Sciences*, 9(19):4142,2019.
- 12) **Liangliang Sun, Yupeng Li, Haiqi Jia, Yu Ying**, Research on Fault Detection Method for Air Handling Units System, *IFAC PapersOnline*, 52(3): 79-84, 2019.
- 13) **Zhi Li, Baolong Yuan, Yupeng Li, Liangliang Sun, Haiqi Jia, Yuanwei Qi, Yuchen Sun**, An Effective Fault Detection and Diagnosis Approach for Chiller System, *IFAC PapersOnline*, 52(10):55-60,2019
- 14) IoanSauciuc,**Yupeng Li**, et al., "Thermal, Socket and Package Integrity Challenges for Organic Lidless Packages Integrated with Land Grid Array Socket Technology" ,*Intel Assembly & Test Technology Journal*, February, 2010.
- 15) Srinivasan Sridharan,**Yupeng Li**, "Delamination behavior of composites" chapter 14 "Competing cohesive layer models for prediction of delamination growth" ,*Woodhead Publishing in Materials*,pp.387-428,2008.
- 16) Srinivasan Sridharan,**Yupeng Li**, "Delamination behavior of composites" chapter 21 "Delamination failure under compression of composite laminates and sandwich structures" ,*Woodhead Publishing in Materials*,pp.618-649,2008.
- 17) Srinivasan Sridharan,**Yupeng Li**, "Two Distinct Cohesive Layer Models in Composite Delamination Investigation" ,*48th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference*, April, 2007, Waikiki, Hawaii.
- 18) Srinivasan Sridharan,**Yupeng Li**, "Dynamic Delamination of Sandwich Columns" , submitted to *2nd International Congress on Computational Mechanics and Simulation (ICCMS-06)*, December 8-10, 2006, Guwahati, India.
- 19) Srinivasan Sridharan,**Yupeng Li**, "Static and Dynamic Delamination of Foam Core Sandwich members" ,*AIAA Journal*, 44(12): 2937-2948, 2006.
- 20) Srinivasan Sridharan,**Yupeng Li**, "FRP Delamination under Lateral Impact and Inplane Compression" ,*2006 SEM Annual Conference on FRP Composites for the Infrastructure*, June 4-7, 2006, St. Louis, MO.
- 21) Srinivasan Sridharan,**Yupeng Li**, "A Study of Quasi-Static Delamination in Sandwich Structures" ,*SMCD2006 Structural Engineering Conference*, May 14-17, 2006, Uwaterloo, Canada.
- 22) S. Sridharan, K. Sunjung,**Yupeng Li**, "Buckling and Nonlinear Behavior of Sandwich Columns" ,*Joint ASME/ASCE/SES Conference on Mechanics and Materials*, June 1-3, 2005, Baton Rouge, Louisiana.
- 23) Srinivasan Sridharan,**Yupeng Li**, "The Dual Role of Cohesive Layer Model in Delamination Investigation" ,*AIAA-2004-1594, 45th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamic & Materials Confer*, April 19-22, 2004, Palm Springs, California.

专利发明:

专利发明9项, 其中美国国家专利1项, 企业保密发明7项。

主要研究成果介绍:

1) 可靠性分析:

在特种计算机领域, 从事产品开发、产品可靠性共性技术研究、批量生产控制、技术创新和超前研发。先后主持过10多个英特尔公司大型项目, 其中包括多个已经上市的系列产品和超前研发项目, 比如: 基于Clarkdale和Lynnfield的1156触点阵列产品平台开发; 基于Sandy Bridge和Ivy Bridge的1155触点阵列产品平台开发; 基于Haswell的1150触点阵列产品平台开发; 超大型服务器系列3177触点阵列产品平台开发; Ultra-small pitch uLGA触点阵列产品超前研发; Baredie无散热封装系列产品超前研发; 设计方法、分析方法、测试方法标准化的研究; Laptop系列的触点阵列Mb-LGA产品超前研发等。先后有多项专利发明, 并多次为美国英特尔公司提出创新型解决方案带来巨额利润, 比如提出创新的基于EOL的设计理念为企业带来5000万美元的经济效益; 提出的LGA1155/56 socket stack的低成本市场方案为企业带来2600万美元的经济效益; 提出创新的接口设计方案

为企业带来26亿美元/年的成本节约等。目前致力于推进国家特种计算机工程技术研究中心沈阳分中心建设,拟建立特种计算机热设计、机械和气候应力、电磁性能等试验能力、建立失效分析与模拟设计优化能力等共性技术能力,服务相关领域科研和成果转化。在其他结构领域,目前致力于小型智能机器人进行水下混凝土结构缺陷识别、结构可靠性评估、大样本数据库建设、模拟维护及预测等关键技术研究。

2) 复合材料结构性能分析:

从事复合材料结构件力学性能研究,提出三维粘结层模型和微观力学模型研究碳纤维复合材料飞机结构件在给定条件下的力学可靠性和层内及层间破坏机制。以科研成果为基础在国际知名刊物发表文章著作多项。

3) 其他:

工业智能领域,提出I5工业智能加工中心的理念,并推进I5机床和I5OS数控系统系列产品的研发和产业化。

主持或参加科研项目(课题)情况:

- 1) 2020年-2021年,2019年制造业高质量发展专项产业链协同创新类项目之“基于CPS的安全可控研祥云故障预测与健康服务系统”项目之联合申报子项目,来源:工信部,80万元,项目负责人。
- 2) 2019年-2022年,国家重点研发计划科技冬奥重点专项之“国家速滑馆智慧场馆建设和应用关键技术研究”项目之课题五“国家速滑馆智慧场馆运行服务关键技术研究”之子课题三“全周期能源综合优化关键技术研究”(2019YFF0301505),来源:100万元,项目负责人。
- 3) 2019年-2021年,辽宁省重点研发计划:微型智能水下检测机器人关键技术研究,来源:辽宁省科技厅,100万元,项目负责人。
- 4) 2011年-2012年,超大型服务器系列3177触点阵列接口产品平台开发,来源:美国英特尔公司,500万美元,项目负责人。
- 5) 2011年-2012年,DLP系列产品开发,来源:美国英特尔公司,100万美元,项目负责人。
- 6) 2010年-2012年,Ultra-small pitch uLGA触点阵列产品平台开发,来源:美国英特尔公司,800万美元,项目负责人。
- 7) 2010年-2012年,1270 H-small和DSL系列产品开发,来源:美国英特尔公司,150万美元,项目负责人。
- 8) 2010年-2012年,Laptop系列的触点阵列Mb-LGA产品平台开发,来源:美国英特尔公司,500万美元,项目主要参与人。
- 9) 2009年-2012年,基于Haswell的1150触点阵列接口产品平台开发,来源:美国英特尔公司,1000万美元,项目负责人。
- 10) 2009年-2012年,Baredie无散热封装系列产品平台开发,来源:美国英特尔公司,900万美元,项目负责人。
- 11) 2008年-2010年,基于Sandy Bridge和Ivy Bridge的1155触点阵列接口产品平台开发,来源:美国英特尔公司,1000万美元,项目负责人。
- 12) 2007年-2009年,基于Clarkdale和Lynnfield的1156触点阵列接口产品平台开发,来源:美国英特尔公司,2500万美元,项目负责人。
- 13) 2006年-2012年,基于Conroe、Kentsfield、Wolfdale、Yorkfield的775和771触点阵列产品平台开发,来源:美国英特尔公司,1200万美元,项目主要参与人。
- 14) 2006年-2012年,标准化,设计方法、分析方法、测试方法等的标准化,来源:美国英特尔公司,500万美元,项目负责人。
- 15) 2001年-2005年,科研基于力学研究应用于飞机上的复合材料结构在冲击作用下的层间破坏机制,来源:美国波音公司和美国圣路易斯华盛顿大学联合项目,300万美元,项目负责人(美国圣路易斯华盛顿大学部分)。

上一条: 李立新 下一条: 李恒昌(二级教授)

【关闭】